

证券代码：688798
转债代码：118065

证券简称：艾为电子
转债简称：艾为转债



上海艾为电子技术股份有限公司

Shanghai Awinic Technology Co., Ltd.

2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年四月

目录

2025 年年度股东会会议须知	3
2025 年年度股东会会议议程	5
议案一：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案	7
议案二：关于《2025 年年度报告》及摘要的议案	8
议案三：关于《2025 年度财务决算报告》的议案	9
议案四：关于《2026 年度财务预算报告》的议案	10
议案五：关于《公司董事 2026 年度薪酬方案》的议案	11
议案六：关于 2026 年度申请综合授信额度并提供担保的议案	12
议案七：关于《2025 年年度利润分配方案》的议案	14
议案八：关于授权公司管理层处置所持上市公司股票的议案	15
议案九：关于续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案	16
议案十：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	17
议案十一：关于修订《募集资金管理制度》的议案	18
附件 1：《上海艾为电子技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》	19
附件 2：《2025 年度财务决算报告》	34
附件 3：《2026 年度财务预算报告》	39

上海艾为电子技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《上海艾为电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海艾为电子技术股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议公司聘请上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-033）。

上海艾为电子技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2026 年 4 月 30 日 14 点 00 分
- 2、现场会议地点：上海市闵行区秀文路 908 号 B 座 15 层
- 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 30 日至 2026 年 4 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- (三) 宣读股东会会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 审议会议各项议案

序号	议案名称
1	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》
3	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
4	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
5	《关于<公司董事 2026 年度薪酬方案>的议案》
6	《关于 2026 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
7	《关于<2025 年年度利润分配方案>的议案》
8	《关于授权公司管理层处置所持上市公司股票的议案》
9	《关于续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案》

10	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

注：本次股东会将听取《上海艾为电子技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东对各项议案投票表决
- (八) 休会（统计表决结果）
- (九) 复会，宣读会议表决结果和股东会决议
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 主持人宣布股东会现场会议结束

议案一：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2025 年度，公司董事会按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规和公司规章的规定及要求，认真履行职责，依法行使职权。根据董事会 2025 年度总体工作情况，公司编制了《2025 年度董事会工作报告》，报告具体内容详见附件 1。

此议案内容已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司股东会，敬请审议。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

议案二：关于《2025 年年度报告》及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，公司认真编制了《2025 年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

此议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司股东会，敬请审议。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

议案三：关于《2025 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2025 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2025 年度财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。公司据此编制了《2025 年度财务决算报告》，报告具体内容详见附件 2。

此议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司股东会，敬请审议。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

议案四：关于《2026 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2026 年度财务预算报告》，具体内容详见附件 3。

此议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司股东会，敬请审议。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

议案五：关于《公司董事 2026 年度薪酬方案》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》等公司相关薪酬管理制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了《公司董事 2026 年度薪酬方案》，具体方案如下：

（一）适用范围

在公司任职并领取薪酬的内部董事及领取津贴的独立董事。

（二）适用时间

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）组织管理

董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对公司薪酬制度的执行情况进行监督。

（四）薪酬（津贴）发放标准

1、内部董事

内部董事薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬。

岗位薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入。

基本薪酬按月发放；绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后，根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放；中长期激励收入由公司根据实际情况制定激励方案。

2、公司独立董事

独立董事 2026 年津贴标准为 9 万元（税前）/年，按月发放。

此议案全体董事回避表决，现提交公司股东会，敬请审议，关联股东回避表决。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

议案六：关于 2026 年度申请综合授信额度并提供担保的议案

各位股东及股东代理人：

为满足日常生产经营与业务发展需求，公司及全资子公司拟在本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止的期间内，向银行等金融机构申请总额不超过人民币 40 亿元（或等值外币）的综合授信额度，并为公司合并报表范围内的全资子公司申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币 30 亿元（或等值外币）的担保额度。该等担保额度可在公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司、孙公司）之间进行调剂。

上述综合授信额度拟用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、并购贷款、合同融资、贸易融资、供应链融资、开具银行承兑汇票、开具信用证、开具保函、汇票贴现、融资租赁等业务。该等授信额度不等于实际融资金额，最终融资金额以公司及子公司与金融机构签订的相关协议及实际发生额为准。

公司为其合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司、孙公司）申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供担保的方式包括保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，具体担保期限以届时签订的担保合同为准。上述申请综合授信额度及提供担保事项经公司股东会审议通过后，股东会授权董事长根据实际需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，就具体申请授信或提供担保事项作出决定并签署相关法律文件，授权公司经营管理层办理相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于 2026 年度申请综合授信额度及为公司全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-021）。

此议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司股东会，敬请审议。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

议案七：关于《2025 年年度利润分配方案》的议案

各位股东及股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币 731,977,548.16 元；公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润为 317,009,892.40 元。公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.3 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 233,128,636 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 100,245,313.48 元（含税）。本年度公司现金分红占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润之比为 31.62%。2025 年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于 2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-023）。

此议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司股东会，敬请审议。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

议案八：关于授权公司管理层处置所持上市公司股票的议案

各位股东及股东代理人：

为更好把握处置窗口、提升处置效率，拟授权公司管理层根据证券市场动态及标的公司情况，适时择机处置公司（含控股子公司）所持有的全部上市公司股票：

- （1）授权公司管理层在授权期内处置上述股票；
- （2）授权公司管理层确定具体处置方案（包括但不限于处置标的、处置价格区间、处置时间段、处置数量及处置方式等）；
- （3）授权的有效期为股东会审议通过本议案之日起 12 个月。

此议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司股东会，敬请审议。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

议案九：关于续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

公司已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为其所拥有证券、期货相关业务执业资格，能够满足为公司提供财务审计和内部控制审计服务的资质要求，同意续聘立信为公司 2026 年度财务和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-024）。

此议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司股东会，敬请审议。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

议案十：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，促进公司持续、稳定、健康发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，现制定《上海艾为电子技术股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

此议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司股东会，敬请审议。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

议案十一：关于修订《募集资金管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法利益，依据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，现修订《上海艾为电子技术股份有限公司募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司募集资金管理制度》。

此议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司股东会，敬请审议。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

附件 1:《上海艾为电子技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

2025 年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《董事会议事规则》等公司制度的规定,认真贯彻执行股东会通过的各项决议,积极推进董事会决议的实施,以切实维护公司利益和本着对全体股东负责的态度,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司持续稳定地发展。现将董事会 2025 年度的主要工作情况报告如下:

2025 年度公司实现营业收入 285,353.14 万元,较上年同期下降 2.71%;实现归属于母公司所有者的净利润 31,700.99 万元,较上年同期增长 24.38%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 22,036.46 万元,较上年同期增长 41.00%;研发费用投入 56,814.72 万元,较上年同期增长 11.59%。

2025 年度公司主要会计数据如下:

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
营业收入	2,853,531,396.80	2,932,929,859.74	-2.71	2,530,921,518.18
利润总额	302,076,679.23	239,320,022.88	26.22	15,377,352.30
归属于上市公司股东的净利润	317,009,892.40	254,880,223.37	24.38	51,008,934.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	220,364,570.22	156,286,988.80	41.00	-89,650,956.97
经营活动产生的现金流量净额	390,713,526.04	402,483,632.40	-2.92	428,799,425.83
	2025年末	2024年末	本期末比上年同期末增减(%)	2023年末
归属于上市公司股东的净资产	4,196,243,546.50	3,923,100,333.85	6.96	3,622,053,913.90
总资产	5,302,026,798.17	5,088,487,195.06	4.20	4,935,797,732.71

2025 年度，公司主营业务分产品情况如下：

单位：元 币种：人民币

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
高性能数模混合芯片	1,505,281,250.28	972,469,573.32	35.40	8.11	0.19	增加 5.12 个百分点
电源管理芯片	1,046,981,251.36	650,647,440.85	37.85	-0.03	-1.66	增加 1.02 个百分点
信号链芯片	296,468,813.22	218,069,438.60	26.44	-39.65	-46.57	增加 9.52 个百分点

一、2025 年度具体经营情况

(一) 坚持创新驱动发展

报告期内，公司对高性能数模混合信号、电源管理、信号链三大类产品持续进行产品创新，持续开拓消费电子、工业互联、汽车市场领域。公司根据客户需求及时进行技术和产品创新，加快产品迭代以及产品性能和成本优化，深化布局工艺平台，现已布局 30 余种工艺，助力实现平台型芯片设计公司的发展目标。截止 2025 年 12 月 31 日公司累计发布产品 1,700 余款，产品子类达到 42 类，年出货量接近 57 亿颗，公司主要产品在报告期内情况如下：

1、高性能数模混合信号芯片

公司凭借音频领域丰富的技术积累，形成了目录化的音频功放产品系列，完成在消费电子、工业互联、汽车等多行业方向布局。采用先进工艺和先进封装，持续进行产品创新，打造高性能模拟功放和内嵌丰富音效算法的 DSP 数字功放；不断升级神仙算法，实现以算法、硬件、系统解决方案三维一体的立体式发展。首款数字中功率功放产品在行业头部客户实现量产，车规 T-BOX 的音频功放芯片/车规 4*80W 音频功放芯片通过 AEC-Q100 认证并开始出货，awinicSKTune® 神仙算法获得行业头部客户认可并实现销售。公司已构建“硬件+算法+服务”的全系统音频生态链，广泛应用于消费、工业互联及汽车领域，生态协同效应已初步形成。公司正式发布首款高性能 NPU 智能语音芯片，通过算法与硬件深度协同，

全面布局端侧 AI 市场。为满足 AI 眼镜、骨传导耳机等新兴可穿戴设备的超低功耗需求，公司同步推出超低功耗、超小封装音频功放系列产品，并已实现向多家可穿戴 AI 终端客户的试产与批量出货。此外，公司首款音频 ADC 产品已成功量产出货，进一步丰富了音频信号链的产品组合，巩固了在音频领域全链路布局的竞争优势。

公司发布新一代压电微泵液冷主动散热驱动方案，超低功耗，超小体积，超静音的主动散热方案满足高算力手机、PC 及 AI 眼镜等 AI 终端设备的散热要求。Haptic 行业首款 Boost 升压构架并支持硅负极电池供电 产品在多品牌手机客户实现试产出货、低功耗小系统面积的 Haptic 产品持续扩大 wearable 和 AIOT 市场、以及车规产品进一步系列化丰富，awinicTikTap® 4D 触觉 Engine 软硬件一体方案获得了更多品牌客户认可和量产。公司在国内首先突破手机摄像头光学防抖 OIS 技术，并已量产了开环/闭环 AF 和 OIS 全系列产品，包括开环单端驱动，低功耗开环中置驱动，集成霍尔传感器的闭环驱动，1 轴~4 轴 OIS 驱动等产品，SMA 马达驱动芯片成功导入品牌客户实现规模化量产出货，摄像头驱动芯片业务实现了全品类规模量产和业绩的平稳增长。公司发布了 30V 以上工业应用的磁传感器位置检测产品和电机驱动产品，进一步丰富了磁传感器和电机驱动产品矩阵。随着全球糖尿病患者数量持续增长，疾病管理已成为公共卫生领域的紧迫任务。连续血糖检测（CGM）作为日常健康管理的重要手段，正逐渐普及。在此背景下，公司面向大健康检测应用，成功推出 nA 级低功耗的 Hyper-hall 技术，助力 CGM 品牌客户实现产品量产，为更高效、更便捷的健康管理提供可靠支持。

公司推出了首款车规级 LIN RGB 氛围灯驱动 SOC 芯片，该产品高度集成了高压 LIN PHY、MCU、高压 LED Driver 和颜色校正算法，为汽车氛围灯提供了优异的单芯片解决方案，在多家客户实现量产出货。同时，公司推出了首款车规级音乐律动 MCU，赋能汽车智能座舱实现动感绚丽的音乐律动氛围灯效，在多个头部新能源汽车客户成功量产。面向手机、工业互联等多元 RGB LED 应用场景，公司正式推出新一代呼吸灯驱动产品系列。该系列产品支持全局高精度电流输出，可精准实现高端 RGB 灯效要求；提供涵盖高性能与超小封装在内的多种规格，灵活适配各类终端设计需求；基于全新架构，从根源上解决 LED Driver 的

啸叫问题，并具备超低 EMI 特性，有助于降低用户整体设计成本。在传感器方面，公司推出了高性能容式触控+压力感应二合一 SoC 芯片系列，广泛用于手机、IoT、可穿戴等应用领域。

2、电源管理芯片

公司围绕 Type-C 端口，积极布局信号路径保护芯片集成 CC/SBU/DPDM 多通道 ESD 保护、水汽检测等功能，在显示器、PC 客户端突破量产；第二代高性能线性充电芯片，芯片尺寸优化 40%，在智能手环、智能戒指、OWS 耳机等 AIoT 客户持续量产出货；公司持续进行 OVP、OCP 技术开发，积极扩展笔记本以及笔记本周边市场，推出超低阻抗 OVP 和双向隔离 OVP 系列化产品以及 OCP 产品系列化推出，为中大功率充放电场景提供安全可靠的防护。

公司推出多款电源管理芯片，包括高 PSRR LDO、低压 Buck、低功耗 buck-boost、单通道高精度背光、多通道高精度背光、高压 IR LED 驱动等。DCDC 方面，低功耗 buck-boost 在多种便携式设备中逐步放量，助力便携式设备长续航，APT buck-boost 产品除在手机上持续出货外，在 5G redcap 方向，持续导入多家模块和工业客户，实现大规模量产，同时突破车载行业重点 Tier1 客户，在汽车 Tbox 应用中提供有力电源保障，提高车载通讯方案的供电效率；LDO 方面，除通用/低功耗 LDO，持续在手机、AIoT、工业大批量出货外，LDO PMIC 在客户端也加速放量；端口保护方面，PC 规格的双向隔离 OVP，陆续在客户端上项目量产；显示电源方面，Amoled Power 在多家头部客户大规模量产出货；MOS 方面，12V 2.2mΩ 锂保 MOS 取得品牌客户突破。传统马达驱动，推出高压多路半桥马达驱动，进一步开拓工业市场领域。

3、信号链芯片

公司推出了首款应用于卫星通讯的宽频 LNA，能够覆盖北斗，天通等多个应用场景，能够增强终端设备的下行性能，为客户提供更好的体验，在多个头部品牌客户完成了导入和量产。相对聚焦在消费市场的同时，射频小器件在更分散的领域和更广阔的应用市场和场景取得了进步，多款针对 AIoT，工业和汽车的专用射频开关和 LNA 在该领域的头部客户量产出货。在路由器市场推出多款 WIFI 开关和 WIFI FEM，丰富了产品类别。

公司在运放&比较器、模拟开关、电平转换、逻辑、基准等品类上全面丰富多款产品。运放&比较器推出高压通用和高压高精度产品，全面进入工业领域。低压通用运放推出单通道、双通道、四通道规格，持续产品系列化并在家电的头部客户实现大规模量产。高性能运放推出纳安运放，多个 CGM 客户导入验证中，并持续在纳安比较器，超低噪声运放等方向持续布局多款产品；高速开关产品系列化，推出高速 7GHz，10GHz 带宽产品。电平转换方面，推出支持超级 SIM 卡协议的 SIM 卡电平转换系列，支持先进工艺低功耗 1.2V 平台，并完成高通、MTK 等主流平台的 AVL 导入。四通道、六通道车规电平转换同年取得 AEC-Q100 认证，并在品牌车企和重点 Tier1 实现了突破。Reset 产品形成多阈值不同输出和封装规格的系列化布局，并成功导入全球头部客户三星的电视产品，实现量产突破。74 逻辑产品方面，推出与非门、或非门、buffer、反相器等品类，继续丰富产品系列。

（二）重视研发团队建设，持续加大研发投入

公司秉持“高素质的团队是艾为的最大财富”价值观，重视研发团队建设。截至报告期末，公司技术人员数量达到 722 人，占公司总人数的 74.59%；研发人员达到 674 人，占公司总人数的 69.63%；公司持续搭建高质量的研发团队，推动公司可持续发展。报告期内，公司坚持创新驱动，不断提升研发质量，2025 年度公司研发费用为人民币 5.68 亿元，在整体营收中占比达到 19.91%。

公司秉持先进的集成电路工艺和设计理念，持续加强研发创新，并在报告期内荣获国家发展改革委认定的国家企业技术中心资质、获颁“国产模拟 IC 行业卓越奖”、获 IEEE 电路与系统协会颁发 AICAS 2025 国际竞赛赛道三优胜奖、智能音频芯片多场景应用质量攻关项目获评上海市重点产品质量攻关成果三等奖、AW85601QPR-Q1、AW23003QNR-Q1、AW13612PFDR-Q1、AW37283B500SPR-Q1、AW39124TSR-Q1 五款车规芯片入编《2025 中国汽车芯片供给手册》、首款 SMA 摄像头马达驱动芯片入选上海设计 100+全球竞赛项目、数字音频功放芯片 AW88166FCR 项目获评“2025 年高转项目自主创新十强”。公司经过多年持续研发投入及技术积累，取得了众多自主研发核心技术，截至报告期末，公司累计取得国内外专利 729 项，其中发明专利 484 项，实用新型专利 238 项，外观专利 7

项；累计在中国境内登记集成电路布图设计专有权 634 项；软件著作权 134 件；取得国内外商标 185 件。

（三）深化质量管理体系建设，提升公司核心竞争力

报告期内，公司持续推进 ISO9001、IATF16949、ISO17025、ESD S20.20、ISO26262 等体系的不断融合，共发布更新管理文件 398 份。通过持续健全质量管理架构，形成了强有力的质量保障、清晰的管理思路及实用的管理工具，从而在深化质量管控和落实持续改进的过程中，不断提升客户满意度。

报告期内，公司持续深化卓越绩效管理，以“AWINIC 卓越管理模式”申报上海市市长质量奖。凭借在管理领域的突出表现，公司成功入围并完成高标准的现场评审。此次申报与评审过程有力驱动了公司管理体系的优化与完善，有效提升了整体管理效能和治理水平。

报告期内，公司进一步落地优化质量数字化建设，项目管理数字化系统和生产数据系统，提前预防产品开发与供应商管理质量，确保产品全生命周期信息的实时监控、自动化数据采集与分析，为产品质量筑起坚实防线，为项目研发管理和研发效率提升奠定了坚实的基础。

报告期内，公司不断加强质量文化建设和持续改进，通过各类质量专题培训、质量推文，红黑榜等不同形式，营造全员积极参与的氛围，不断增强员工的工作质量和持续改进意识，实现了公司项目开发质量和交付质量的大幅提升，助力公司全面提升质量管理水平、实现可持续发展。

（四）建设工艺平台、构筑坚实壁垒

在 2025 年的市场环境下，公司紧密贴合行业趋势，持续发力于供应链管理体的深度完善。当前，全球供应链领域正历经深刻变革，人工智能与自动化成为革新供应链的核心驱动力，作为国内数模混合芯片领域龙头企业，公司进一步加大数字化与智能化投入，在供应链管理领域，借助前沿的 AI 技术，强化产业链上游信息协同，构建 AI 驱动的智能信息交互平台，实现与供应商的信息流、资金流与物流信息共享与交互，并借助 AI 进行建模与分析，精准洞察市场动态，使供应链协同效应得到前所未有的提升，有力推动供应链数智化转型升级，以敏捷和高效响应市场需求变化。

在设备和材料的国产化推进方面，鉴于国内半导体产业蓬勃发展态势以及供应链安全重要性日益凸显，公司与国内众多优质供应商紧密合作，集中资源加速推进国产设备和材料在上游厂商的国产化验证进程。已在关键制程和重要技术指标上取得显著突破，为产品竞争力提升与供应链安全稳定筑牢根基。

从市场需求维度来看，2025 年消费类市场呈现出智能化、绿色化的升级趋势，工业和汽车市场对产品的性能、可靠性要求也不断攀升。公司敏锐捕捉这些变化，进一步丰富和拓展对应产品线。针对工业和汽车市场，研发出高性能、高可靠性的定制化产品，并全面更新和完善多领域产品线路标，依据产品路标科学完成工艺平台的路标规划与演进方向的迭代，在确保产品技术始终契合市场需求下，持续提升技术的竞争力和创新力。

报告期内，公司深度协同全球头部晶圆代工资源，持续深化长期稳定战略合作伙伴关系。依托顶尖代工厂的先进晶圆制造工艺，公司加速推进面向工业与汽车领域的高端产品落地，并在上游工艺联合开发方面取得关键突破——COT（客户自有技术）实现重大进展，显著增强了核心工艺自主可控能力。技术布局层面，公司进一步巩固 BCD 工艺领先优势：90nm 节点已实现规模化量产，55/40nm 节点研发按计划稳步推进；同时，超低功耗工艺技术的突破性升级，精准赋能端侧 AI 产品的长效续航需求，持续强化“技术开发-应用落地”的商业闭环能力，为公司构筑了显著的市场先发优势。

报告期内，随着先进封装技术在提升产品性能、降低综合成本方面的优势日益凸显，公司与全球领先的封装测试代工厂深化战略合作，并加速布局包括 Fan-out（扇外型封装）在内的先进封装技术路线。公司积极拓展高散热、大功率封装等多元化产品类型，显著提升了产品矩阵的广度与市场竞争力。同时，公司持续推进在更窄引脚间距和更薄封装体上的技术创新与产品开发，致力于以“轻、薄、小”的封装解决方案，充分满足端侧 AI 及便携式设备领域对芯片小型化与高性能的持续需求。

（五）建立测试平台，全面提升测试能力

报告期内，面对市场竞争和技术挑战，公司积极推进测试平台的升级工作，聚焦于标准化和数字化能力建设。其中，自主研发的新型射频测试机台已成功发布并投入使用；同时，模拟测试机台的相关验证工作正有序推进，处于数据收集

阶段。此项升级工作正逐步提高测试效率，降低测试成本，满足业务增长需求，其全面实施将有效缩短产品上市时间，进一步巩固和提升市场竞争力。

（六）持续发力行业标准建设 多领域引领产业高质量发展

报告期内，公司在行业标准建设领域持续深耕发力，以核心技术为根基多赛道布局标准体系搭建，不断提升行业话语权，全方位推动产业规范化、高质量发展。公司以第一起草单位发起的《虚拟现实触觉反馈系统设计要求》《虚拟现实触觉反馈系统评价方法》两项标准顺利进入发布流程，为国内虚拟现实触觉反馈集成电路研发与生产企业提供体系化的设计规范与标准化的评价体系，进一步完善国内触觉反馈技术标准体系，推动行业技术的规范化、产业化升级；以第一起草单位主导的《音频智能诊断标准》正式在 IEEE 完成立项，填补了音频智能诊断领域的国际标准空白，充分彰显公司在音频领域的技术实力与国际话语权，持续巩固公司在音频行业的全球领先地位；由公司牵头编制的《车载音频 车载氛围灯驱动芯片路线图》、公司作为核心参与单位编制的《电源和信号链车载芯片路线图》于报告期内正式发布，为车载芯片领域的技术研发、产品迭代与产业链协同提供清晰的发展指引，助力车载芯片产业国产化升级，推动汽车电子行业高质量发展。公司始终以标准建设为重要抓手，推动技术创新与产业发展深度融合，持续为全行业技术升级与可持续发展贡献核心力量。

（七）完善产业链布局，形成完整生态链助力芯片研发高质量发展

报告期内，上海临港车规级测试中心项目进展顺利：整体工程项目按预定计划顺利推进。“墨水瓶”园区已正式亮灯并进入内部装修阶段，目前正在积极申请临港及上海市级的检验检测与中试平台资质，以期未来向社会开放，助力行业生态发展。2025 年，中心成功完成了全自动包装产线与自动化机器人的中试测试，为建成芯片测试领域首条拥有全自动测试产线的“灯塔工厂”奠定了基础。该中心计划于 2026 年 5 月整体投入使用，届时将成为国内规模最大的综合性车规级测试验证平台，显著提升公司在高端制造领域的服务与保障能力。

（八）持续推进全业务场景 AI 能力覆盖，提升数据驱动科学管理能力

报告期内，公司已上线 70 个智能体应用，各部门 SOP 覆盖率超 25%，AI 使用量超 300%，大幅提升个人工作及企业运营效率。公司官网建设持续加速，月均访问量提升 5 倍，其中商城成交金额提升超 10 倍。公司设计开发平台建设已

完成一期建设，全面进入运营推广阶段，产研数字化平台通过多维度数据驱动运营改善，全面提升项目各项指标持续优化，其中项目研发周期缩短 10%，为进一步提升公司研发效能打下坚实基础。公司始终重视信息安全工作，在 2025 年 10 月上海市网安总队组织的攻防演练中实现 0 失误，同时通过用户行为管理能力的全面升级，整体提升了信息安全技术水平，确保公司数据安全。

（九）加强人才体系建设，全面提升企业竞争力

截至报告期末，公司员工人数达到 968 人，本科及以上学历员工占比 91.53%。公司持续推进人才战略体系化建设，通过完善长效激励与系统化人才管理机制，持续夯实企业技术创新与高质量发展的核心竞争力。

在人才梯队建设上，公司建立健全战略型干部管理体系，制定科学规范的选拔、培养与评价标准，着力锻造一支使命担当、责任过硬、领导力突出的干部队伍，成为驱动组织持续突破、引领发展的核心引擎。

在核心人才与能力体系建设方面，研发高精尖人才队伍建设成效显著，人才结构与专业能力持续优化。公司同步搭建覆盖全产品体系的任职资格管理标准，以标准化能力模型规范员工职业发展路径，实现人才精准培养、精准选拔。

在激励机制建设上，以全面绩效管理为基础，持续优化以岗位贡献与个人绩效为核心的薪酬激励体系，健全基于责任贡献的获取分享机制，坚持公平公正、价值导向。通过物质激励与精神激励有机结合，有效激发员工创新活力与奋斗动能，形成业绩增长与人才发展双向赋能的良性循环，为公司长远发展提供坚实的人才支撑与机制保障。

二、公司核心竞争力分析

1、领先的核心技术优势

（1）技术积累丰富，具备持续创新能力

公司技术、客户、供应链、人才等多项优势紧密结合、发展迅猛。技术方面，公司积累了大量模拟芯片设计开发经验，截至 2025 年 12 月 31 日，公司及控股子公司累计获得发明专利 484 项，实用新型专利 238 个，外观设计专利 7 个，软件著作权 134 个，集成电路布图登记 634 个。

（2）产品领域延伸性强，响应国产化替代需求

公司秉持现代化的集成电路工艺和设计理念，在集成电路设计领域积累了大量的技术经验。公司在数模混合信号链领域深耕多年，紧跟核心电子产品的发展趋势、持续进行产品创新。公司从高性能数模混合信号芯片、电源管理芯片、信号链芯片产品出发，陆续拓展丰富子类产品线，各类产品技术持续发展，形成了丰富的技术积累及较强的技术竞争力，积极覆盖新智能硬件的国产化替代需求。

（3）细分市场具备较强的产品和技术优势

公司主要产品包括高性能数模混合信号芯片、电源管理芯片、信号链芯片等，在各个细分市场中均具备自身独特的竞争优势。其中，公司在高性能数模混合信号芯片领域形成了丰富的技术积累和完整的产品系列，发展出集硬件芯片和软件算法为一体的音频解决方案；在马达驱动芯片领域较早地进行了技术研发及积累，品类不断丰富，在国内企业中具有较强的先发竞争优势，特别是在 Haptic 触觉反馈和 Camera AF&OIS 领域。在电源管理芯片和信号链芯片领域持续扩充产品种类，并在下游应用市场持续进行拓展。

2、人才团队优势

集成电路设计属于智力密集型行业，人才是集成电路设计企业的最关键要素。公司高度重视研发和管理人才的培养，积极引进国内外高端技术人才，目前已建立了成熟稳定的研发和管理团队。截至 2025 年 12 月 31 日，公司共有技术人员 722 人，占全部员工人数的比重达 74.59%，主要研发和技术人员平均拥有十年以上的工作经验；共有核心技术人员 5 人，领导并组建了由多名集成电路设计行业资深人员组成的技术专家团队，构成公司研发的中坚力量。

公司重视人才管理体系建设，在人才管理职业发展通道、薪酬激励体系、干部管理体系、招聘管理等系统及建设方面起步早，保持行业领先。公司制定了员工职级职等管理政策、干部管理政策、技术职位任职资格管理体系等一系列人才培养政策。公司持续引入行业顶尖人才，关注处于不同职业阶段的员工能力提升，加速人才体系化建设，为企业技术创新发展提供了持续的人才资源，实现人力资源的合理配置与科学化管理，打造支撑公司长期发展的组织能力和人才梯队，全面提升企业竞争力。此外，公司优质的人才保障制度和文化氛围，不断增强创新人才吸引力和凝聚力，支撑公司持续创新。

3、产品市场优势

公司产品主要应用于消费电子、工业互联、汽车领域，通过多年的积累，公司拥有丰富且齐全的产品系列，公司产品在技术领域覆盖高性能数模混合芯片、电源管理芯片、信号链芯片，产品型号达到 1,700 余款。公司开发的音频功放芯片、背光驱动、呼吸灯驱动、闪光灯驱动、过压保护、GNSS 低噪声放大器、FM 低噪声放大器、马达驱动等各类产品在消费电子、工业互联、汽车的市场得到广泛认可，并广泛应用于知名品牌厂商的终端产品，公司研发的多款产品在半导体领域获得了诸多奖项。

4、客户资源优势

公司拥有丰富的客户资源，已纳入众多知名品牌客户的合格供应商名录。公司产品以新智能硬件为应用核心，通过突出的研发能力、可靠的产品质量和细致的客户服务，覆盖了包括三星、小米、OPPO、vivo、传音、TCL、联想、微软、Samsung、Meta、Amazon、Google 等众多品牌客户，以及华勤技术、闻泰科技、龙旗科技等知名 ODM 厂商；车载领域客户包括比亚迪、阿维塔、零跑、奇瑞、长安、吉利、现代等。公司在可穿戴设备、智能便携设备和物联网、工业、汽车等细分领域，持续拓展了细分领域知名企业。

5、业务连续性优势

报告期内，公司业务连续性规则体系进一步健全，覆盖采购、生产、物流及 IT 支持等关键环节，并通过内部审计与演练确保有效执行。单一料号多供应商策略拓展至更多核心物料，国产设备导入比例显著提升，增强了供应链的自主可控性。数据备份机制升级为多层级架构，保障数据安全与业务恢复能力。仓储网络在原有基础上新增区域分仓，提升了物流韧性及响应效率。同时，公司继续推进供应链数字化平台建设，通过实时数据监控与风险预警，提升对市场波动的预见性与适应能力，为应对复杂多变的外部环境奠定了更坚实的基础。

三、公司治理

报告期内，公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。公司将进一步加强经营管理

和内部控制，全面提升经营管理水平，提升经营和管理效率，控制经营和管理风险。

（一）股东与股东会

报告期内，公司共计召开了 3 次股东会。股东会的召集、召开程序、出席股东会的人员资格及股东会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和公司《股东会议事规则》的规定，保证全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内的股东会均由董事会召集召开，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定应由股东会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。公司聘请专业的律师进行现场见证并出具法律意见书，对会议召集、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见，确保股东会的规范运作。

（二）董事与董事会

报告期内，董事会共召开 8 次会议，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的相关规定履行了信息披露义务。会议的召集与召开程序、出席会议均符合法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。公司第四届董事会由 6 名董事组成，其中 2 名独立董事。公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，公司全体董事依法开展工作，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《上海艾为电子技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，积极参加股东会、董事会，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观发表独立、公正的判断。

公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和意见。

2025 年度，公司顺利完成职工董事增设工作。通过职工代表大会民主选举程序，选出既代表职工利益、又具备半导体行业专业素养的职工董事。

（三）公司与控股股东

公司控股股东及实际控制人为孙洪军先生。报告期内，公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定和要求，规范自身行为，不存在超越公司股东会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，不存在利用其控制地位损害公司和其他股东利益的行为，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会和内部机构独立运作。

（四）信息披露与透明度

公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及《信息披露管理制度》的规定，依法履行信息披露义务，秉持公平、公正的原则，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，使所有股东有平等的机会获得信息，保障中小股东知情权，充分维护投资者利益。

（五）投资者关系

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视与投资者的沟通与交流，公司配备了专职人员负责信息披露和投资者关系管理工作，认真对待股东网络提问、来电和咨询，听取广大投资者对公司经营管理及战略发展的意见和建议，切实保证中小股东的合法权益。

四、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

半导体行业分为集成电路、光电器件、分立器件、传感器等子行业，集成电路又分为逻辑、模拟和存储等细分行业。在半导体行业中，模拟芯片是必不可少的一部分。模拟芯片无处不在，几乎所有常见的电子设备都需要使用模拟芯片。模拟集成电路是虚拟世界与现实世界的物理桥梁，模拟电路起到电路系统与外界环境交互的接口作用，扮演电路系统的“口”和“眼”，存在于几乎所有的电子产品和设备中。模拟芯片产品种类繁多，功能齐全，广泛应用于通信、工业、汽车、

消费以及政企系统等领域，具有稳定持续成长性。通信领域主要涉及无线基础设施及有线网络；汽车领域主要涉及驾驶辅助和动力系统；工业领域主要涉及航空航天、医疗设备及工业自动化；消费领域主要涉及计算机、手机和平板电脑；政企领域主要包含各类服务器等。根据美国半导体行业协会（SIA）统计，2025 年全球半导体销售额实现 7,917 亿美元，较 2024 年的 6,305 亿美元增长 25.6%。SIA 进一步预测，2026 年全球销售额有望攀升至约 1 万亿美元，其中，北美主要云服务商在 AI 基础设施领域的投资将达到 6,000 亿美元，重点投向 AI 芯片、高带宽存储及大规模算力集群，从而对上游半导体形成直接而持续的需求拉动。与此同时，边缘 AI 计算、汽车电子化与工业智能化的多场景融合与快速渗透，也为半导体行业长期增长注入了多元而坚实的动力。

未来，伴随着电子产品在人类生活的更广泛普及以及 5G 通信、物联网和人工智能等新兴产业的革命为整体行业发展提供动力，集成电路行业有望长期保持旺盛的生命力。模拟集成电路在整个行业中占比稳定，随着电子产品应用领域的不断扩展和市场需求的深层次提高，拥有“品类多、应用广”特性的模拟芯片将成为电子产业创新发展的重要动力之一。

目前全球模拟芯片国际市场竞争格局呈现高集中度的特点，主要被欧美厂商占据。国际龙头模拟芯片企业经历几十年的发展形成了大而全的产品形态。近年来国际上的大规模企业并购使得大企业的规模继续扩大，一定程度上形成了强者恒强的局面。如 TI（德州仪器）、Analog Devices（亚德诺）、Infineon（英飞凌）等龙头厂商，依靠其长期积累的丰富的产品线，全球研发与销售布局和规模经济效应，以及产业链更加独立自主的 IDM 模式，国际龙头模拟企业在全范围内具有明显的竞争优势。

随着经济持续发展，中国已成为全球最大的电子产品生产国，并由此衍生出庞大的集成电路器件需求。目前，中国不仅是全球最大的模拟芯片市场，其整体市场规模仍在稳步扩大。根据国家统计局发布的《2025 年国民经济和社会发展统计公报》，2025 年中国集成电路产量达到 4,842.8 亿块，较 2024 年增长 10.9%。与此同时，人工智能（AI）正以前所未有的深度重塑集成电路行业，特别是在设计优化、自动化效率提升以及产品集成度等方面带来显著变革。AI 技术的发展不仅推动了集成电路技术的创新与产品多样化，也进一步刺激了市场需求的增长，

成为行业迈向高端化的重要引擎。

我们坚信：在中国宏观大势下，集成电路产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量，公司的不断成长是必然的。我们将通过 Fabless 的道路，去追赶海外模拟巨头，并不断缩小差距。

（二）公司发展战略

公司致力于持续开发全系列的高性能数模混合信号、电源管理、信号链的集成电路产品，打造集成电路设计行业领先的技术创新平台。公司坚持技术创新进步，凭借着深厚的集成电路技术储备和成熟的行业应用解决方案，持续推出在性能、集成度和可靠性等方面具有较强竞争力的音频功放芯片、电源管理芯片、射频芯片、马达驱动芯片等产品，同时通过优质的技术服务为消费电子、工业互联网、汽车等领域的新智能硬件产品提供可靠的技术支持。

公司以“用科技的力量创造美好未来，用心为客户、员工、合作伙伴和股东创造价值”为使命，努力提升核心技术水平、产品性能及客户服务能力，以自主创新为驱动，不断推动企业发展，矢志成为具有国际竞争力的高性能数模混合芯片、电源管理芯片、信号链芯片设计公司，服务全球客户。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

附件 2：《2025 年度财务决算报告》

公司 2025 年度财务决算报告以立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并报表为基础编制。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了“信会师报字[2026]第 ZA10882 号”标准无保留意见的审计报告。

一、主要财务数据和财务指标

1、主要财务数据

单位：人民币元

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期增减 (%)	2023年
营业收入	2,853,531,396.80	2,932,929,859.74	-2.71	2,530,921,518.18
利润总额	302,076,679.23	239,320,022.88	26.22	15,377,352.30
归属于上市公司股东的净利润	317,009,892.40	254,880,223.37	24.38	51,008,934.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	220,364,570.22	156,286,988.80	41.00	-89,650,956.97
经营活动产生的现金流量净额	390,713,526.04	402,483,632.40	-2.92	428,799,425.83
	2025年末	2024年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2023年末
归属于上市公司股东的净资产	4,196,243,546.50	3,923,100,333.85	6.96	3,622,053,913.90
总资产	5,302,026,798.17	5,088,487,195.06	4.20	4,935,797,732.71

2、主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期增 减(%)	2023年
基本每股收益（元 / 股）	1.36	1.1	23.64	0.22
稀释每股收益（元 / 股）	1.36	1.1	23.64	0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.95	0.67	41.79	-0.39
加权平均净资产收益率（%）	7.82	6.78	增加1.04个百分点	1.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.44	4.16	增加1.28个百分点	-2.51
研发投入占营业收入的比例（%）	19.91	17.36	增加2.55个百分点	20.05

二、报告期内公司财务状况、经营成果和现金流量情况

1、财务状况及变动情况分析

单位：人民币元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
应收账款	129,391,102.78	2.44	73,668,902.34	1.45	75.64	说明 1
预付款项	13,855,321.82	0.26	8,849,121.59	0.17	56.57	说明 2
一年内到期的非流动资产	108,806,222.12	2.05			不适用	说明 3
其他流动资产	58,895,873.27	1.11	38,391,264.63	0.75	53.41	说明 4
其他债权投资			105,561,777.73	2.07	-100.00	说明 5
在建工程	476,504,685.81	8.99	310,938,841.14	6.11	53.25	说明 6
长期待摊费	10,050,578.29	0.19	20,848,586.33	0.41	-51.79	说明 7

用						
应付账款	438,233,151.54	8.27	290,283,066.47	5.70	50.97	说明 8
其他应付款	22,574,253.97	0.43	8,638,574.82	0.17	161.32	说明 9
长期借款	77,986,829.52	1.47	142,175,241.64	2.79	-45.15	说明 10
租赁负债	2,968,840.12	0.06	4,332,007.52	0.09	-31.47	说明 11
一年内到期的非流动负债	72,143,906.27	1.36	249,123,654.23	4.90	-71.04	说明 12
其他应收款	3,981,414.89	0.08	6,705,317.75	0.13	-40.62	说明 13
其他非流动资产	19,969,882.91	0.38	4,186,035.26	0.08	377.06	说明 14
长期应付职工薪酬	26,205,953.10	0.49			不适用	说明 15

变动情况说明：

情况说明	变动原因
说明 1	主要系报告期内直销客户销售额增长，应收账款相应的增加。
说明 2	主要系本期预付的采购货款增加所致。
说明 3	主要系一年内到期的大额存单。
说明 4	主要系报告期内留抵的进项税增加所致。
说明 5	主要系一年内到期的大额存单列报至“一年内到期的非流动资产”所致。
说明 6	主要系“车规级可靠性测试中心”项目的建设所致。
说明 7	主要系租赁的办公场地装修费在本期摊销所致。
说明 8	主要系报告期内第四季度采购额较同期增加，形成期末应付账款的增加。
说明 9	主要系报告期内收到的政府补助项目款未确认所致。
说明 10	主要系将一年内到期的银行借款列报至“一年内到期的非流动负债”所致。
说明 11	主要系报告期内公司按租赁合同约定按期支付租金，租赁负债余额相应减少所致。
说明 12	主要系报告期内偿还了银行长期借款所致。
说明 13	主要系本报告期公司押金及保证金的减少所致；
说明 14	主要系预付“车规级可靠性测试中心”项目建设款所致。
说明 15	主要系报告期内增加了中长期激励基金所致。

2、经营成果及变动情况分析

单位：人民币元

科目	2025 年度	2024 年度	变动比例 (%)
营业收入	2,853,531,396.80	2,932,929,859.74	-2.71
营业成本	1,842,651,065.38	2,040,410,660.64	-9.69
销售费用	97,065,820.49	108,473,576.02	-10.52
管理费用	154,712,604.13	144,530,938.78	7.04
财务费用	3,814,374.95	-4,715,521.27	不适用

研发费用	568,147,221.47	509,122,052.76	11.59
信用减值损失	3,615,550.64	1,749,677.87	106.64
资产减值损失	9,295,943.22	32,453,545.03	-71.36
公允价值变动收益	8,082,359.85	21,364,655.84	-62.17

营业收入变动原因说明：主要系行业周期性波动导致报告期内收入略有下降，但公司通过强化工业互联、汽车芯片等高附加值领域布局，新产品在消费电子、工业互联等市场的份额持续提升，公司通过提升高毛利产品的份额，维持了整体毛利率提升的趋势。

营业成本变动原因说明：主要系公司报告期内销售产品结构变动及销售数量减少等因素，使得营业成本较同期下降。

销售费用变动原因说明：主要系报告期内职工薪酬及股份支付费用的减少所致。

管理费用变动原因说明：主要系报告期内折旧摊销费及中介机构服务费的增加。

财务费用变动原因说明：主要系报告期内汇率变动汇兑收益较同期减少、增强资金管理利息收入增加，综合后财务费用较上年同期增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系报告期内职工薪酬及工程开发费增加所致。

信用减值损失变动原因说明：主要系报告期末应收账款增加，计提的信用减值损失较上年同期增加所致。

资产减值损失变动原因说明：主要系以前年度已计提减值的存货本期实现对外销售并转销对应的跌价准备，且本期新增存货可变现净值较高，无需大额计提减值所致计提的跌价准备减少所致。

公允价值变动收益变动原因说明：主要系处置了一部分持有的上市公司股票，导致公允价值变动减少。

3、现金流量及变动情况分析

单位：人民币元

项目	2025 年度	2024 年度	同比 增减 (%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	390,713,526.04	402,483,632.40	-2.92	现金流量净额较上年同期下降 2.92%，整体变动幅度较小。
投资活动产生的现金流量净额	-182,874,034.52	-681,837,077.75	不适用	主要系①报告期内购买的理财产品较上年同期减少；②报告期内购置的资产较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-314,630,170.80	-87,880,686.29	不适用	主要系①报告期内偿还的银行借款较上年同期增加；②报告期内现金股利支付金额较上年同期增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-109,387,654.13	-355,866,018.24	不适用	

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

附件 3：《2026 年度财务预算报告》

根据上海艾为电子技术股份公司（以下简称“公司”）2025 年度实际经营情况以及下一年度生产经营发展目标，现将公司 2026 年度财务预算情况报告如下：

一、预算编制说明

2026 年度财务预算报告是基于公司 2025 年度的实际经营情况、财务状况和经营成果，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了 2026 年度的财务预算。

二、预算编制期

本预算编制期为：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、预算编报范围

本预算与 2025 年决算报表合并范围一致。

四、预算编制的基本假设

- 1、公司遵循的我国现有法律、法规、政策和所在地经济环境无重大变化。
- 2、公司遵循的税收制度和有关税收优惠政策无重大变化。
- 3、公司主要税率、汇率、银行存贷款利率等不发生重大变化。
- 4、公司销售和生产计划能如期实现。
- 5、公司生产经营所需的主要材料价格、公司的主要产品价格能基本保持在预算价格的合理范围内波动。
- 6、无其它不可预见因素和人力不可抗拒因素造成的重大不利影响。
- 7、本预算未考虑资产并购、新增股权激励等不确定事项的影响。

五、2026 年度财务预算主要指标

根据 2026 年度的经营目标和工作计划，在充分考虑宏观经济形势、市场环境、产业链状况等因素的基础上，公司将积极拓展市场，加强管理与成本控制，保持 2026 年度公司营业收入和净利润有所增长。

六、完成 2026 年财务预算的措施

- 1、加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理效率；
- 2、有效地利用企业资源，确保企业效益最大化；
- 3、规范全面预算管理，有效实现企业的经营目标；

- 4、规范预算管理的职责分工，权限范围和审批程序；
- 5、合理安排、使用资金，提高资金利用率。

七、特别说明

上述预算为公司 2026 年度经营计划的前瞻性陈述，不代表公司的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。该经营计划能否实现取决于宏观环境、国家政策、行业发展、公司经营决策等诸多因素，该经营计划存在较大的不确定性，请投资者保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日